Soldeerpasta NO-CLEAN TLF-204-171A, loodvrij, voor drukprocessen, 1 patroon = 600 g

De loodvrije soldeerpasta TLF-204-171AK is ontwikkeld om te voldoen aan de eisen van veeleisende drukprocessen. De pasta biedt uitstekende drukeigenschappen, zowel bij koude als bij warme omstandigheden, waardoor de vorming van ongewenste bruggen wordt vermeden. Door de verbeterde activering van de flux minimaliseert TLF-204-171AK head-in-pillow defecten. Tegelijkertijd leidt de goede activering tot een goede bevochtiging van gewone metalen oppervlakken. Bevochtigings- en soldeerkraaltests en contourstabiliteit voldoen aan de hoogste eisen. TLF-204-171AK is een NO-CLEAN pasta - de resten kunnen op de soldeerverbindingen achterblijven zonder problemen met corrosie of elektromigratie te veroorzaken.

- Soldeerpasta NO-CLEAN, loodvrij
- voor drukprocessen
- Classificatie ROL0
- Metaalgehalte 88,5
- Legering Sn96,5Ag3Cu0,5
- Korrelgrootte 4 (20-38 µm)
- 1 patroon = 600 g
- Vermindering van hoofd-in-kussen defecten
- Hoge activiteit op alle substraten
- Goede bevochtiging op gewone metalen oppervlakken
- Uitstekende drukeigenschappen
- Goede hechting tot 24 uur
- Fluxclassificatie J-STD-004: ROL0

Artikelnr.	**WL45185**
Model	Pastentyp TLF-204-171AK
Fabrikant	TAMURA ELSOLD
Fabrikant artikelnr.	LOTPAST8004
GPSR-fabrikantgegevens	TAMURA DEUTSCHLAND GmbH Hüttenstraße 1 DE-38871 Ilsenburg www.tamura-elsold.de
Verkoopeenheid	1 patroon
Inhoudseenheid	600 g
Fluxklasse	ROL0
Loodvrij/loodhoudend	ongelood